

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明



(上) 、HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

A. W. ORO CO. S. P. CO. O. H. W. ORO CO. S. P. CO. O. H. W. ORO CO. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. CO. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. C. O. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. C. O. O. H. W. O. R. O. C. O. S. P. C. O. O. C. O. 您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

support@hisilicon.com 客户服务邮箱:

前言

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3519A	V100

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 00B01 (2018-11-15)

第1次临时版本发布

目 录

前	言	.i
1 Hi	3519AV100 功耗测试报告	1
	1.1 Hi3519AV100 功耗测试环境及说明	, 4/
	1.2 功耗测试场景以及相应的功耗数据	1
	1.3 结论	3/1/2

【 Hi3519AV100 功耗测试报告



注意

本测试报告仅用于分享基于当前测试样本和环境的客观记录,从而为客户自行测试做一定程度的参考,测试结果不代表对任何规格、功能、性能等的承诺,也不具备任何约束力。如有疑问,可核对芯片手册。

1.1 Hi3519AV100 功耗测试环境及说明

测试对象	HI3519AV100 demblite 板			
电源	6A 电源适配器			
测温设备	点温计			
加温设备	高低温箱(温箱型号是风热温箱,温箱风速约 1m/s)			
主芯片散热方式	单板放置于温箱中,依靠 PCB 和芯片表面对流散热,芯片加散热片,规格为 35x35x12mm ,散热片详细规格见《Hi3519AV100 硬件设计用户指南》散热设计参考章节。			

1.2 功耗测试场景以及相应的功耗数据

NVR 典型功耗测试场景

业务描述(NVR 读文件解码 + NNIE 分类网)

8 路 1080P30 解码, 其中 2 路解码过 VPSS 出 2 路 720p 给 NNIE,然后送 VO 显示; 其余 6 路解码过 VPSS 也送 VO 显示;一路音频输入输出,采样率为 16K_16bit_2chn; 各模块频点: A53(1500M)、DDR(2664M)、VPSS(710M)、VGS(630M)、VEDU(568M)、VDH(500M)、NNIE(840M)

- CPU 工作频率: 1500MHz; CPU 占用率: 约 100%
- DDR 工作频率: 2667MHz; DDR 占用率: 约 68%, 典型功耗数据如下表所示。

环境温度	结温	Core 功耗	CPU_Media 功耗	1V8 功耗	1V2 功耗	总功耗
25℃	48℃	510.54mW	569.85mW	142.20mW	276.01mW	1498.60mW

IPC 典型功耗测试场景

业务描述(4K302合1WDR 输入)

Sensor334 + VI 4K30 2 合 1 WDR 输入(pipe0 FE-BE 在线 pipe1 FE-BE 离线)+ 4K30 DIS (6DOF_GME;开 LDC) +4K30 VPSS (viproc-vpss 离线;3DNR 使能; 4 路输出) +VPSS chn0 输出压缩 4k30 给 H265 编码 (码率 10Mbps,SMARTP) 和 JPEG 抓拍 + chn1 输出 1080P30 给 H265 编码(码率 3Mbps,NormalP)+ chn2 传给 VO(HDMI 1080p60 显示)+ 一路音频(采样率为 16K_16bit_2chn)+大小码流点播。

各模块频点: A53(1500M)、DDR(2667M)、VI(600M)、ISP(300M)、VIPROC(600M)、VPSS(600M)、GME(600M)、VGS(630M)、GDC(630M)、VEDU(750M)

- CPU 工作频率: 1500MHz; CPU 占用率: 约 100%
- DDR 工作频率: 2667MHz; DDR 占用率: 约72%, 典型功耗数据如下表所示。

环境温度	结温	Core 功耗	CPU_Media 功耗	1V8 功耗	1V2 功耗	总功耗
25℃	57℃	621.49mW	1126.36mW	172.80mW	281.95mW	2202.6mW

NVR 最大功耗测试场景

业务描述(NVR 读文件解码 + NNIE 分类网)

8 路 1080P30 解码, 其中 2 路解码过 VPSS 出 2 路 720p 给 NNIE,然后送 VO 显示;

其余 6 路解码过 VPSS 也送 VO 显示; 一路音频输入输出,采样率为 16K_16bit_2chn; 各模块频点: A53(1500M)、DDR(2664M)、VPSS(710M)、VGS(630M)、VEDU(568M)、VDH(500M)、NNIE(840M)

- CPU 工作频率: 1500MHz; CPU 占用率: 约 100%
- DDR 工作频率: 2667MHz; DDR 占用率: 约 68%, 最大功耗数据如下表所示。

环境温度	结温	Core 功耗	CPU_Media 功耗	1V8 功耗	1V2 功耗	总功耗
70℃	97℃	682.31mW	809.51mW	151.20mW	277.99mW	1921.01mW

IPC 最大功耗测试场景

业务描述(4K302合1WDR输入)

Sensor334 + VI 4K30 2 合 1 WDR 输入(pipe0 FE-BE 在线 pipe1 FE-BE 离线)+ 4K30 DIS (6DOF_GME;开 LDC) +4K30 VPSS (viproc-vpss 离线;3DNR 使能; 4 路输出) +VPSS chn0 输出压缩 4k30 给 H265 编码 (码率 10Mbps,SMARTP) 和 JPEG 抓拍 + chn1 输出 1080P30 给 H265 编码(码率 3Mbps,NormalP)+ chn2 传给 VO(HDMI 1080p60 显示)+ 一路音频(采样率为 16K_16bit_2chn)+大小码流点播。

各模块频点: A53(1500M)、DDR(2667M)、VI(600M)、ISP(300M)、VIPROC(600M)、VPSS(600M)、GME(600M)、VGS(630M)、GDC(630M)、VEDU(750M)

- CPU 工作频率: 1500MHz: CPU 占用率: 约 100%
- DDR 工作频率: 2667MHz; DDR 占用率: 约72%,最大功耗数据如下表所示。

环境温度	结温	Core 功耗	CPU_Media 功耗	1V8 功耗	1V2 功耗	总功耗
70°C	110℃	854.20mW	1529.93mW	185.40mW	282.35mW	2851.88mW

1.3 结论

- 要求必须采用 SVB 调压技术(基于 Hi3519AV100R001SPC010 及后续版本)。
- 客户的散热设计必须确保芯片 Tj (结温) 温度不高于 110℃。